(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[5]
H01L 23/28

(11) 공개번호 특1991-0013519
(43) 공개일자 1991년08월08일

(21) 출원번호 특1990-0019158
(22) 출원일자 1990년11월23일
(30) 우선권주장 458585 1989년12월29일 미국(US)
(71) 출원인 에스지에스-톰슨 마이크로일렉트로닉스, 인코포레이티드
미합중국, 텍사스 75006, 카롤론, 일렉트로닉스 드라이브 1310
(72) 발명자 가스퍼 에이.부테라
미합중국, 펜실베니아 19422, 블루베르 테이어 드라이브 1590
(74) 대리인 이병문, 이태희

심사청구 : 없음

(54) RF 트랜지스터 패키지

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

RF 트랜지스터 패키지

[도면의 간단한 설명]

첨부도면은 본 발명에 따른 패키지의 3차원 확대도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

입력측(input), 출력측(output), 그리고 반도체의 각 단자들을 그와 함께 접속시키기 위한 공통 단자를 갖는 반도체 패키지에 있어서, 지지체 부재; 상기 지지체 부재위에 장착되어 있고 상기 반도체를 수용하기 위한 열전도성, 전기 절연성의 패드; 상기 패드위에 장착된 반도체; 보호용 뚜껑을 포함하고, 상기 패드는 플라즈마 증착된 질화알루미늄, 진공 증착된 다이아몬드, 플라즈마 증착된 알루이나 및 플라즈마 증착된 질화붕소로 구성된 군으로 부터 선택되는 재료를 포함하는 패키지.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 재료가 플라즈마 증착된 질화붕소인 패키지.

청구항 3

제2항에 있어서, 상기 패드가 7내지 8밀의 두께를 갖는 패키지.

청구항 4

제1항에 있어서, 상기 재료가 플라즈마 증착된 질화알루미늄인 패키지.

청구항 5

제4항에 있어서, 상기 패드가 7내지 8밀의 두께를 갖는 패키지.

청구항 6

제1항에 있어서, 상기 재료가 진공 증착된 다이아몬드인 패키지.

청구항 7

제6항에 있어서, 상기 패드가 0.3내지 0.5밀의 두께를 갖는 패키지.

청구항 8

제1항에 있어서, 상기 재료가 플라즈마 증착된 알루미나인 패키지.

청구항 9

제8항에 있어서, 상기 패드가 7내지 8밀의 두께를 갖는 패키지.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1

